

Pelnox®

产品名称	ZC-210
产品分类	半导体用树脂 单组分树脂
主要用途	半导体模组 一般模组
主要功能	单组分 低应力 低固化收缩 低翘曲

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	ZC-210
外观	目测	—	黑色液体
粘度	25°C 1rpm	Pa·s	780
	25°C 2rpm	Pa·s	550
	25°C 5rpm	Pa·s	360
	25°C 10rpm	Pa·s	260
TI值	0.5/5rpm 25°C	—	3.0
比重	浮力法	—	1.84

标准固化条件 160°C-1小时

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
硬度	JIS K 7215 25°C	邵氏D	96
线收缩率	120×10×10(mm)	%	0.23
玻璃化温度	JIS K 7197 TMA	°C	175
线膨胀系数	Tg以下	10 ⁻⁵ /°C	1.5
	Tg以上	10 ⁻⁵ /°C	8.0
体积电阻率	JIS K 6911 25°C	Ω·cm	7.2 x 10 ¹⁶
	PCT 24小时后	Ω·cm	2.9 x 10 ¹³
剪切粘接力	JIS K 6850 25°C 铁	MPa	7
	JIS K 6850 25°C 铝	MPa	11
	JIS K 6850 25°C 铜	MPa	14
	JIS K 6850 25°C 氧化铝	MPa	6

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 東京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022